

底部填充胶|无卤素底部填充胶|CSP底部填充胶|BGA底部填充胶

产品名称	底部填充胶 无卤素底部填充胶 CSP底部填充胶 BGA底部填充胶
公司名称	深圳市赫邦新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜观光路1165号致意工业园2栋3楼
联系电话	0755-21001477 13164750776

产品详情

典型应用

[底部填充剂](#)被广泛应用于以下装置：ASICs的FC CSPs和FC BGAs、芯片组、图形芯片、数据处理器和微处理器。可以满足因低K值材料应用而对底部填充剂提出的低变形、细间距、高可靠性和高附着力的要求。

产品特点：快速流动，快速固化，有较长的工作寿命。

产品	应用	粘度 @25 [cps]	颜色	工作寿命@25	固化条件	
4517	高可靠性，快速流动	3500	米黄色	7天	5分钟@150	-5
4550	低温固化，3mil间隙	3000	黑色	28小时	5分钟@100	-4
4551	低温固化，1/2mil间隙，快	1100	黑色	2天	5分钟@100	-4

速流动						
4581	快速流动, 可维修性	1500	黑色	7天	5分钟@150	-5
4582	快速流动, 高可靠性	1800	米黄色	7天	5分钟@150	-5